

【景美科技 2026 年 4 月營收新聞稿】

景美科技(7899) 4 月營收 再創歷史新高

連續四個月改寫同期紀錄 1-4 月累計年增逾 66%

2026 年 5 月 8 日 / 新北市

先進製程測試介面結構件供應商 景美科技 (7899) 今 (8) 日公告，2026 年 4 月合併營收達新台幣 71,063 仟元，較去年同期(YoY)成長 56.47%，刷新公司成立以來單月營收最高紀錄，並寫下連續四個月 (2026 年 1 月、2 月、3 月、4 月) 合併營收皆改寫歷年同期最高紀錄之里程碑。累計 2026 年前 4 月合併營收約新台幣 250,492 仟元，較去年同期大幅成長約 66.80%，展現公司在 AI 與先進製程測試需求升溫帶動下的強勁營運動能。

4 月寫下歷史新高 連續四個月同期創高 結構性成長軌跡明確

景美科技財務長 涂玉欣表示，景美科技自 2026 年 1 月起，1 月、2 月、3 月、4 月合併營收皆改寫歷年同月份紀錄，連續四個月同期創高，4 月並進一步突破 3 月所創之歷史單月新高。觀察月度營運趨勢，公司營收並非單月跳升或受短期因素拉抬，而是進入結構性成長階段，反映客戶端對先進製程測試介面結構件需求持續放大。1-4 月累計營收較去年同期成長 66.80%，亦顯示中長期成長趨勢已明確成形。

核心客戶訂單延續穩定 多元產品結構同步擴大

景美科技發言人 鄭雅文 表示，4 月營收再寫紀錄，主要反映以下三項核心動能：

第一，核心客戶-全球最大晶圓代工廠訂單持續穩定發展。隨著該客戶於先進製程節點之測試需求逐步放量，公司於探針卡關鍵結構件、細微鑽孔件之穩定供貨地位獲得進一步鞏固，1-4 月相關出貨呈現顯著年成長，為公司營運最重要的中長期成長基石。

第二，產品組合更加多元、出貨基礎更加扎實。隨 AI、HPC 及先進製程晶片設計持續推進，探針卡單卡針數提升、孔位密度增加，公司在導板細微鑽孔、精密結構件加工與整合組裝等多項產品線均同步成長，並非依賴單一產品線拉抬，整體營運基礎更為穩固。

第三，第二季訂單能見度延續第一季強勁態勢。展望未來，隨既有客戶訂單延續成長軌跡，加上新專案陸續進入量產階段，公司對於延續成長動能深具信心。

在 AI、先進封裝與高階測試需求長期成長趨勢明確下，景美科技將持續以技術領先、品質穩定與量產交付三大核心優勢，穩步推升營收與獲利成長，朝向全球先進製程測試介面關鍵結構件供應商目標穩健邁進。

全球信賴的半導體測試介面核心專家
(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)

景美科技自結營收簡表 (公開資訊觀測站公告營收)： 單位：新台幣仟元；%

年度/月份	2026 年	2025 年	增減百分比
4 月	71,063	45,417	YoY +56.47%
1~4 月	250,492	150,174	YoY +66.80%

新聞發言人：品牌總經理鄭雅文 winwin_cheng@cmat-tek.com.tw 0933-888-334

公司簡介：

半導體先進製程測試介面 關鍵結構件供應商 景美科技股份有限公司 (7899.TW) 於 2026 年 2 月 25 日正式登錄興櫃交易。公司成立於 2006 年，專注於半導體先進製程探針卡細微鑽孔與結構件之設計、製造與銷售，實收資本額約新台幣 2.29 億元。景美科技深耕探針卡結構件近 20 年，客戶涵蓋全球最大晶圓代工廠、歐美日韓探針卡廠及台灣前三大探針卡廠，產品包含晶圓測試(CP)用垂直式探針卡 (VPC) 與微機電探針卡 (MEMS) 之關鍵結構件，核心產品涵蓋上下導板細微鑽孔 (Upper Plate / Lower Plate)、ATE Stiffener、Spacer、JIG、Backer 等高精度、高門檻關鍵結構件，為高階晶片測試不可或缺的重要組成。

景美科技之競爭優勢包括：1.具備完整之探針卡結構件設計與開發能力。2.兼具高強度合金金屬材料、高性能工程塑膠與複合材料之整合實力。3.以高精度組裝工藝有效控制公差累積，確保模組功能性與高度可靠性。4.具備少量多樣高客製化的彈性製造能力。5.以夥伴思維深度融入客戶供應鏈，建立互補協作模式並加速產品認證。